



適切に選まれた森林からの原料を含むFSC®認証紙之類に配合した植物油のインキを使用
しています。



www.obara-g.com

OBARA-G REPORT

第62期 第2四半期報告書

2019年10月1日………2020年3月31日

証券コード 6877

株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。OBARA GROUPの2020年第2四半期連結累計期間における事業の概況等をご報告致します。

世界経済は、新型コロナウイルス感染症の広がりを受け、多方面の経済活動が抑制されたことにより、悪化基調となりました。

我が国経済につきましては、設備投資に底堅さが見られたものの、同感染症の影響から生産活動や個人消費の減少など、景気的大幅な下押しが見られました。

そのような外部環境の下、溶接機器関連事業が、自動車メーカーの慎重な設備投資動向への対応に努め、平面研磨装置関連事業が、堅調な生産活動が続いたエレクトロニクス関連素材への拡販活動を図りましたが、当社の業績は、前年同期を下回る結果となりました。

なお、当社は株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要政策として認識しており、2020年度の第2四半期末配当金につきましては、1株につき40円とし、本年6月8日を支払開始日とさせていただきます。



今後も不透明な経済環境が予想されますが、当社と致しましては、引き続き成長市場への経営資源の投入を積極的に推進し、顧客ニーズを満たす製品及びサービスの提供を行うことにより、業績向上に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、OBARA GROUPへの倍旧のご支援を心よりお願い申し上げます。

2020年6月

取締役社長 小原 康嗣

目次	株主の皆様へ ▶01	セグメント別事業概況 ▶05	主要経営指標の推移 ▶11	会社情報 ▶16	株主メモ ▶18
	営業の概況 ▶03	トピックス ▶09	連結財務データ ▶13	株式情報 ▶17	



連結業績サマリー

(百万円)

	第2四半期累計期間			通期		
	前期	当期	前年同期比	前期	当期(予想)	前期比
売上高	27,606	21,307	△22.8%	51,727	44,000	△14.9%
営業利益	5,496	3,367	△38.7%	9,619	6,900	△28.3%
経常利益	5,816	3,845	△33.9%	10,084	7,600	△24.6%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	4,048	2,549	△37.0%	7,476	4,900	△34.5%
1株当たり配当金	40円	40円	—	110円(年間)	110円(年間)	—

(注) 前期の期末配当金(確定)／1株当たり配当金70円
 当期の期末配当金(予想)／1株当たり配当金70円

03

第2四半期累計期間の概況について

当社グループと深く関わる自動車業界につきましては、世界経済の動向を受けて慎重な設備投資が行われ、生産活動も総じて減速状況が続きました。一方、同じく当社グループと深く関わるエレクトロニクス業界では、半導体デバイス向け設備投資に一部活性化の動きも見られる中、エレクトロニクス関連素材では堅調な設備投資が継続しました。

当社グループは、このような経営環境において各市場動向に応じた拡販に努め、ローカルニーズに対応した製品投入を進めたものの、第2四半期連結累計期間の業績は前年同期を下回る結果となりました。

通期の見通しについて

新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、2020年2月28日に連結業績予想を下方修正しました。

足元の経営環境から、売上高440億円(前期比14.9%減)、営業利益69億円(前期比28.3%減)、経常利益76億円(前期比24.6%減)、親会社株主に帰属する当期純利益49億円(前期比34.5%減)を予定しております。

当社グループとしましては、業績の向上に鋭意注力すべく、成長市場での販売促進を鋭意図るとともに、継続的に設備投資と研究開発を行ってまいります。

なお、当連結業績予想は、1米ドル=108.50円の為替レートを前提としております。

セグメント別事業概況

溶接機器
関連事業

事業紹介

溶接機器関連事業とは

自動車業界を主要マーケットとする高効率な抵抗溶接機器を製造・販売しています。

自動車が出来るまで

●溶接機器関連事業と関わる自動車の製造プロセス

車体溶接

塗装

ぎ装

完成

出荷



車体溶接の設備

OBARA GROUP が提供する溶接機器

自動車ボディは薄板鋼板で構成されるため、抵抗溶接という接合工法が採用されています。

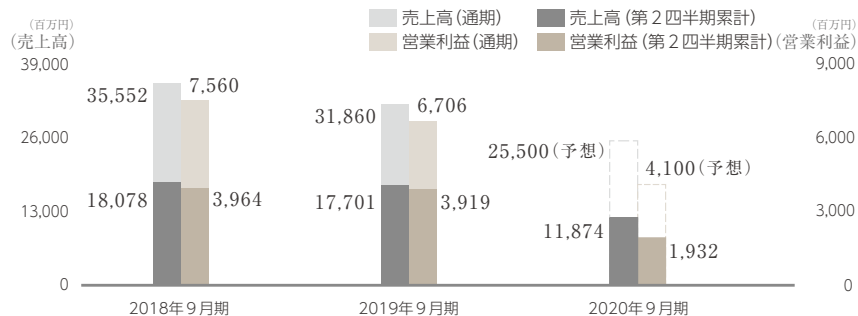
抵抗溶接は、接合ポイントに適切な加圧力と溶接電流を与える必要があります。自動車ボディの組立てには、各自動車モデル固有の立体形状に合わせ、個々の接合ポイントにカスタマイズされた溶接機器が設計・製造されます。

私たちは、国内外の自動車メーカーが行う設備増強やモデルチェンジに伴う設備更新に対し、半世紀に亘って培った経験と最先端の設計・生産技術により、最適な抵抗溶接設備を提案します。日々の生産活動に不可欠な消耗品と合わせ、自動車業界のパフォーマンス要望に応えます。

溶接機器関連事業



溶接ガン



(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

溶接機器関連事業につきましては、中国市場において、春節後、設備需要の早期堅調化が見られたものの、世界各地で、取引先の設備投資が総じて弱含む流れを示しました。

このような環境の下、当事業として設備品及び消耗品の拡販を図ったものの、業績は前年同期を下回りました。

この結果、当事業売上高は118億74百万円(前年同期比32.9%減)、同営業利益は19億32百万円(前年同期比50.7%減)となりました。

売上高構成比

11,874百万円.....2020年9月期
第2四半期累計売上高

平面研削装置関連事業

溶接機器
関連事業

55.7%

セグメント別事業概況

平面研磨
装置
関連事業

事業紹介

平面研磨装置関連事業とは

エレクトロニクス業界を主要マーケットとする精密研磨装置を製造・販売しています。

エレクトロニクス製品が出来るまで

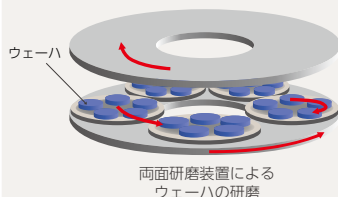
●平面研磨装置関連事業と関わるエレクトロニクス製品の製造プロセス

ウェーハ製造工程
インゴット引き上げ、切断、
ウェーハ研磨

半導体デバイス前工程
成膜、リソグラフィ、
エッチング等

半導体デバイス後工程
ダイシング、ボンディング、
モールドイング等

エレクトロニクス製品組込
完成した半導体デバイス(チップ)の
エレクトロニクス製品への搭載

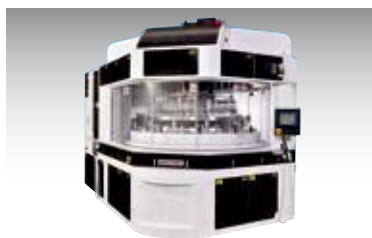


OBARA GROUP が提供する平面研磨装置

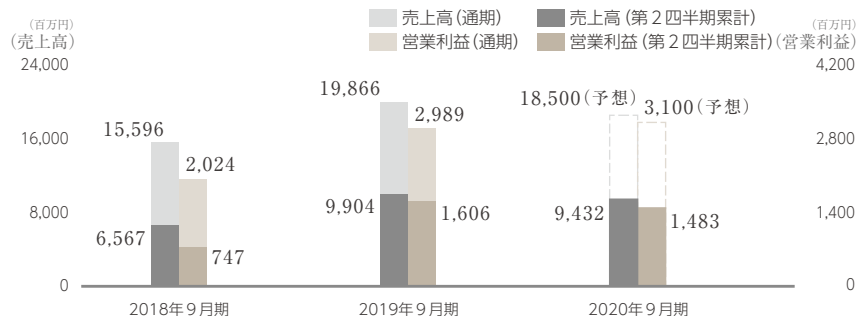
精密加工により製造される先端エレクトロニクス製品は、材料段階で高い面精度を基準平面として要求します。ロジックチップ・メモリーなどの半導体デバイスに用いられるシリコンウェーハ、通信・光デバイス基板、ハードディスク基板など、多様なエレクトロニクス素材の面精度の形成に、ダメージのない微細加工が可能な、遊離砥粒研磨装置が活躍しています。

現代社会を支える各種エレクトロニクス素材の期待水準に、私たちは、ナノオーダー対応の遊離砥粒研磨装置を中心とした精密装置ラインナップで応えます。また、信頼性の高い量産プロセスの確立に必要な、スラリー・研磨パッドなどの消耗副資材も開発・販売しています。

平面研磨装置関連事業



両面研磨装置



(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

売上高構成比

9,432百万円 2020年9月期
第2四半期累計売上高

溶接機器
関連事業

平面研磨装置関連事業 44.3%

平面研磨装置関連事業につきましては、フラッシュメモリー等の需給に改善が見られ、取引先であるエレクトロニクス関連素材においても堅調な生産活動が続きました。

このような環境の下、当事業として販売促進を図ったものの、取引先における設備投資ボリュームの短期的な変動の影響もあり、業績は前年同期を下回りました。

この結果、当事業売上高は94億32百万円(前年同期比4.8%減)、同営業利益は14億83百万円(前年同期比7.7%減)となりました。

株主還元及び資本効率の向上施策

当社の株主各位に対する利益還元につきましては、これを経営上の重要政策として認識し、業績の状況、グループを取り巻く環境及び中長期的な財務体質の強化策を勘案して、配当及び機動的な自己株式の取得等を通じ、継続的かつ安定的に実施することとしております。

この方針の一環として、2020年4月に、成長戦略の実施に必要な財務基盤を維持しつつ、株主還元の強化と資本効率の向上を図るため、自己株式の取得(総額上限6,010百万円・取得期間2021年4月14日まで)を決定し、その資金の調達手段として新株予約権付社債の発行を実施いたしました。株主還元の強化に加え、自己資本利益率(ROE)を含む資本効率の向上といった資本戦略をあわせることで、企業価値の継続的な向上を目指してまいります。

平面研磨装置関連事業／ SEMICON Japanに出展

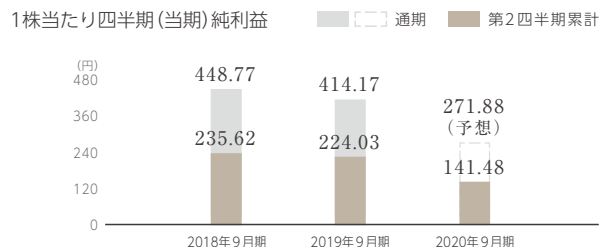
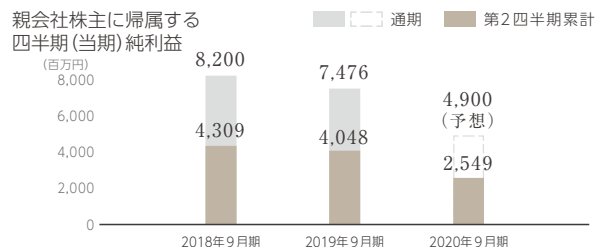
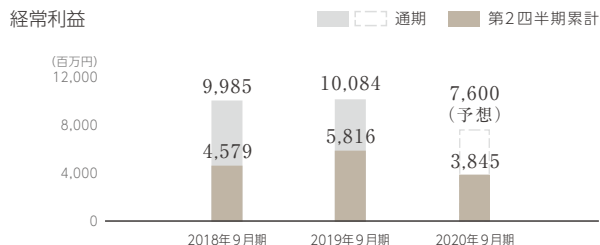
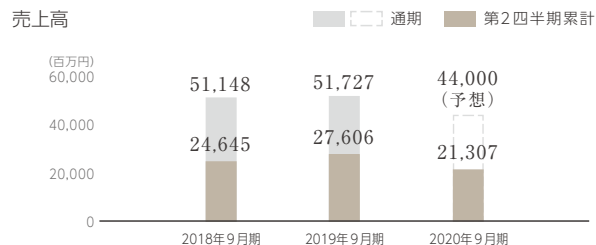
スマートフォンなどのエレクトロニクス製品には最先端の半導体デバイスが搭載され、そのデバイスが形成されるシリコンウェーハの高精度化が進んでいます。2019年12月、東京ビッグサイトで開催された半導体製造技術の展示会「SEMICON Japan」にて、当社グループは、次世代300mmシリコンウェーハに適應した装置・消耗副資材の総合ソリューションを提案したほか、SiCやGaNなどの新素材や、高周波・極薄水晶基板などに対応した最新の研磨装置ラインナップを紹介し、国内外から注目を集めました。



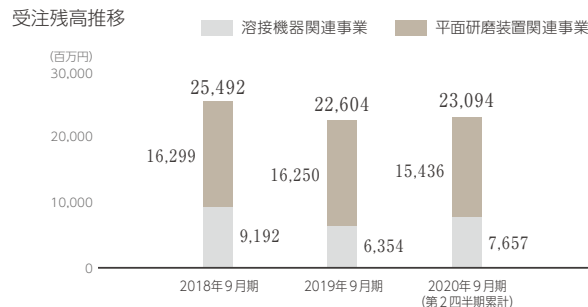
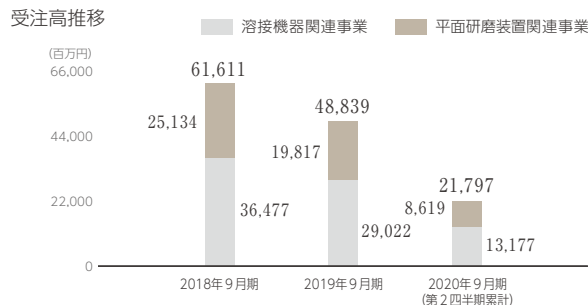
SEMICON Japan 2019

主要経営指標の推移

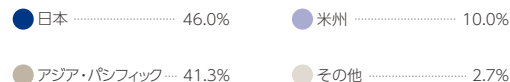
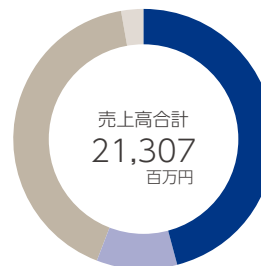
詳細情報は当社IRサイトをご覧ください。 <http://www.obara-g.com/jp/ir/library/index.html>



11



地域別売上高構成比



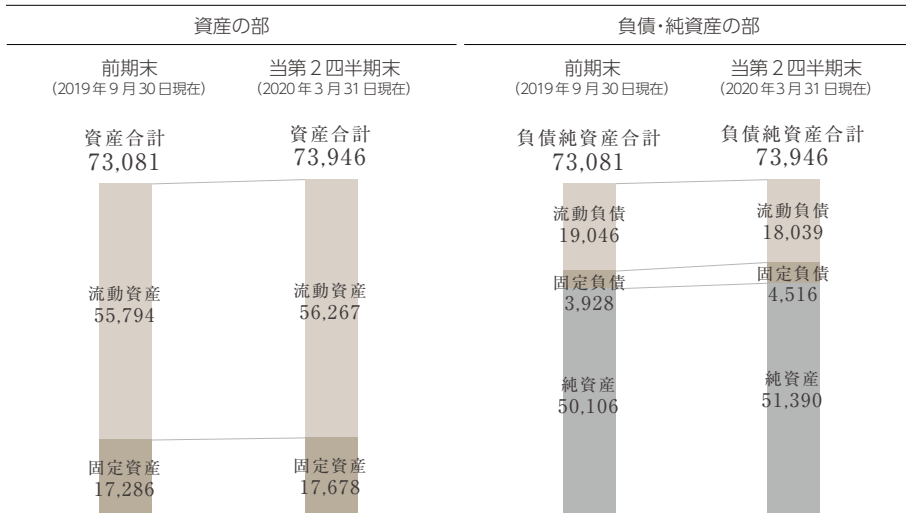
(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

12



資産・負債・純資産の状況

(単位：百万円)



point
1

資産負債

総資産は739億46百万円と、前期末に比べて8億65百万円増加しました。受取手形及び売掛金が22億19百万円減少した一方、現金及び預金が28億38百万円増加したことなどにより、負債は225億56百万円と、前期末に比べて4億18百万円減少しました。前受金が3億13百万円、長期借入金が5億89百万円増加した一方、短期借入金が3億9百万円、賞与引当金が5億47百万円、流動負債のその他が3億70百万円減少したことなどにより、純資産は513億90百万円と、前期末に比べて12億83百万円増加しました。利益剰余金が12億88百万円増加したことなどにより、純資産は513億90百万円と、前期末に比べて12億83百万円増加しました。利益剰余金が12億88百万円増加したことなどにより、純資産は513億90百万円と、前期末に比べて12億83百万円増加しました。

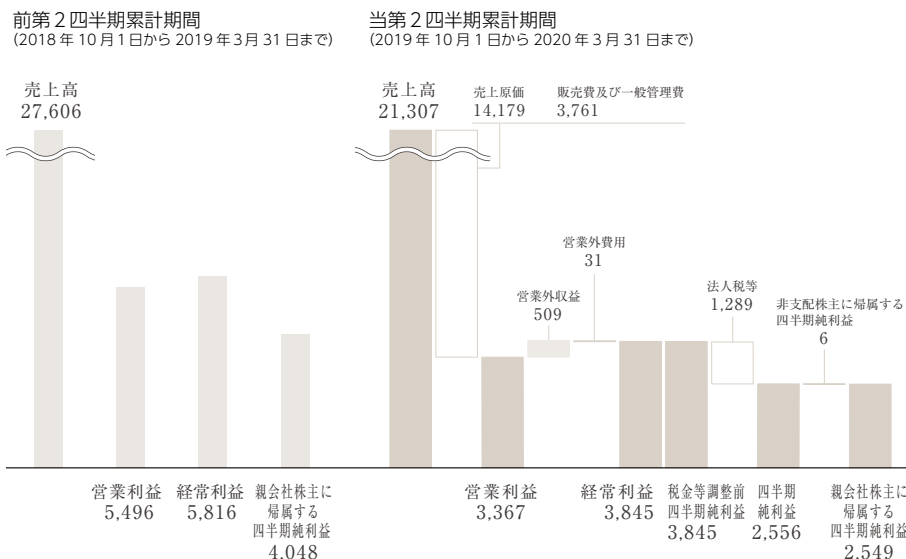
point
2

純資産

純資産は513億90百万円と、前期末に比べて12億83百万円増加しました。利益剰余金が12億88百万円増加したことなどにより、純資産は513億90百万円と、前期末に比べて12億83百万円増加しました。

損益の状況

(単位：百万円)



point
3

売上高・営業利益・
経常利益・親会社株主に
帰属する四半期純利益

連結売上高は、213億7百万円(前年同期比22.8%減)、営業利益33億67百万円(前年同期比38.7%減)、経常利益38億45百万円(前年同期比33.9%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は、25億49百万円(前年同期比37.0%減)となりました。

point
4

営業外収支

受取利息2億39百万円、為替差益1億30百万円など、営業外収益が5億9百万円となった一方、支払利息15百万円など、営業外費用が31百万円となりました。

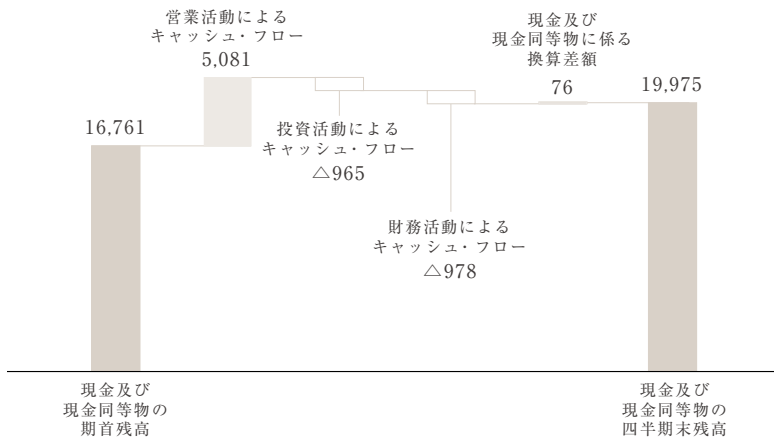
連結財務データ

キャッシュ・フローの状況

当第2四半期累計期間

(2019年10月1日から2020年3月31日まで)

(単位：百万円)



point 5 営業活動による キャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は50億81百万円の増加となりました。税金等調整前四半期純利益が38億45百万円、売上債権の減少額26億94百万円となった一方、法人税等の支払額が12億24百万円発生したことなどによります。

point 6 投資活動による キャッシュ・フロー

投資活動により支出した資金は9億65百万円の減少となりました。有形固定資産の取得による支出が10億93百万円発生したことなどによります。

point 7 財務活動による キャッシュ・フロー

財務活動により支出した資金は9億78百万円の減少となりました。長期借入れによる収入が6億45百万円となった一方、配当金の支払額が12億59百万円発生したことなどによります。

15

会社情報

(2020年3月31日現在)

会社概要

商号	OBARA GROUP 株式会社
設立	1958年12月
資本金	19億25百万円
従業員数	単体：21名(連結1,789名)
本社所在地	神奈川県大和市中央林間 3-2-10 046-271-2111(代表)
主な事業	持株会社として、グループ全体の経営戦略の策定・ 推進、グループ経営の監査、その他経営管理
ウェブサイト	http://www.obara-g.com/

役員

取締役社長	小原 康嗣
取締役	小林 憲史
取締役	山下 光久
社外取締役	大西 倫雄*
社外取締役	牧野 宏司*
常勤監査役	高井 清
社外監査役	須山 正志*
社外監査役	高橋 昌子*

* 証券取引所が定める独立役員として届出を行っております。

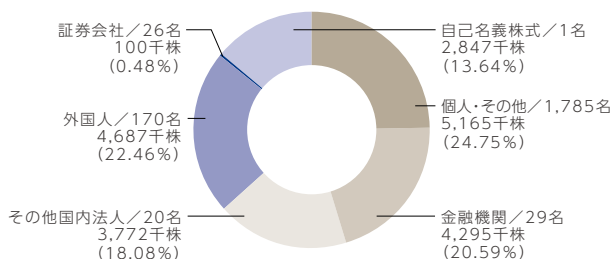
16

株式情報 (2020年3月31日現在)

株式状況

発行可能株式総数	38,000,000株
発行済株式総数	20,869,380株
単元株式数	100株
株主数	2,031名

株主分布状況



大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
有限会社馬込興産	3,703	20.55
小原 康嗣	2,571	14.26
JP MORGAN CHASE BANK 385632	1,083	6.01
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	1,031	5.72
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口9)	1,002	5.56
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	734	4.07
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 380578	507	2.81
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505253	461	2.56
株式会社三菱UFJ銀行	369	2.05
GOVERNMENT OF NORWAY	333	1.85

(注) 1. 上記のほか、自己株式2,847千株を保有しております。
 2. 持株比率は、自己株式2,847千株を控除して計算しております。
 3. 小原康嗣の持株数は自身の管理分株数1,084千株を加えて表示しております。

株主メモ

事業年度	毎年10月1日から翌年9月30日まで
定時株主総会	毎年12月
基準日	定時株主総会の議決権 毎年9月30日 期末配当 毎年9月30日 第2四半期末配当 毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
株主名簿管理人	〒100-8233 東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社
特別口座の 口座管理機関	東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱所 (郵便物送付先 お問い合わせ先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉2-8-4 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL: 0120-782-031(フリーダイヤル)
同取次窓口	三井住友信託銀行株式会社 全国各本支店

公告方法 当公司公告につきましては、下記ウェブサイトに掲載いたします。
<http://www.obara-g.com/>
 但し、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に公告を掲載いたします。

年間IRスケジュール

